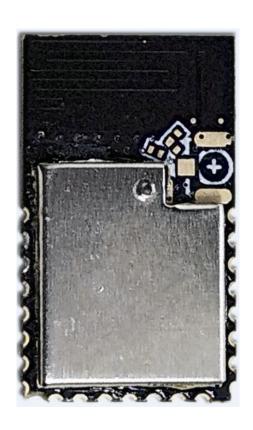


# 低功耗蓝牙(BLE)透传模块规格书 HM-BT4531B





# 目录

| 1   | 产品概述          | 3  |
|-----|---------------|----|
| 2   | 模块特点          | 3  |
| 3   | 电气特性          | 4  |
| 4   | 模块功能说明        | 4  |
| 5   | 应用示意图         | 5  |
| 6   | 模块引脚          | 5  |
|     | 6.1 模块引脚分布    | 5  |
|     | 6.2 模块引脚定义    | 6  |
| 7   | 模块尺寸          | 7  |
| 8   | 硬件设计注意事项      | 8  |
| 9   | 常见问题          | 9  |
|     | 9.1 传输距离不理想   | 9  |
|     | 9.2 易损坏——异常损坏 | 9  |
|     | 9.3 误码率太高     | 10 |
| 10  | 回流焊条件         | 10 |
| 11  | 静电放电警示        | 10 |
| 12. | 文档变更记录        | 11 |
| 13. | 联系方式          | 11 |



#### 1 产品概述

HM-BT4531B是一款基于新一代高性能、超低功耗蓝牙5.1芯片CMT4531实现的蓝牙模块,采用32位ARM® Cortex®-MO 内核最高频率64MHz片上集成48KB SRAM256KB FLASH集成先进的5.1 BLE射频收发器,搭载集成PCB天线和外置天线座,支持无线数据透传功能,通过与外部MCU进行通信,可以快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的无线连接和数据通信,外部MCU的资源占用低,开发过程简单。

#### 2 模块特点

- 基于 ARM® Cortex®-MO 32 位处理器内核;
- 支持低功耗蓝牙 2.4GHz 多协议:
- 低功耗蓝牙协议栈可支持 4. X 到 5. 1,可升级协议栈;
- 片上集成 256KB 的 FLASH 和 48KB 的 RAM;
- 21 个支持复用功能的 GPIO, 可自由配置映射, 外设使用更灵活:
- 可以做透传模块使用,也可以单独用作 MCU;
- 模块接口为通用串口,全双工双向通讯;
- 支持 AT 指令软件复位模块, 获取 MAC 地址;
- 支持 AT 指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率(动态功耗调整):
- 支持 AT 指令调整发射功率,修改广播间隔,自定义广播数据,自定义设备识别码,设定数据延时(外部 MCU 串口接收的准备时间),修改串口波特率,修改模块名称,支持掉电保存:
- 串口缓存大,可一次性往串口输入不超过 5K 字节数据
- 支持移动设备 APP 修改模块名称,掉电保存,修改串口波特率,产品识别码,自定义广播内容,广播周期;
- 支持移动设备 APP 对模块进行复位,设置发射功率:
- 支持移动设备 APP 调节蓝牙连接间隔, 掉电不保存(动态功耗调整);
- 支持防劫持密码设置,修改和恢复,防止第三方恶意连接,可不使用;



- 广播内容提示模块实时状态,包括电池电量,自定义设备识别码(适合 广播应用方案);
- 支持内部 RTC 实时时钟:

#### 3 电气特性

- 工作电压: 1.8V-3.6V
- 工作温度: -20℃~+85℃
- 调制模式: GFSK 高斯频移键控
- 调制频率: 2402MHz 2483.5MHz
- 接收电流: 3.8mA @1Mbps GFSK
- 发射电流: 4.2mA @OdBm/3.3V
- 深度睡眠模式: 1.4uA @3V Deep Sleep(48KB RAM 保持)
- 最大发射功率: +6dBm
- 接收灵敏度: -94dBm @1Mbps GFSK

#### 4 模块功能说明

模块启动后会自动进行广播,已打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和连接,成功连接后可通过 BLE 协议对其进行操作。外部 MCU 可以通过模块的串口与移动设备进行双向通讯,外部 MCU 也可以通过串口,以及控制指令,对模块的通信参数进行控制。

用户数据格式由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行 写操作,写入的数据将通过模块接口发送给外部 MCU。模块接口收到外部 MCU 的数据包后,将自动转发给已经连接的移动设备。用户需要完成外部 MCU 的代码设计以及移动设备的 APP 代码设计。



## 5 应用示意图

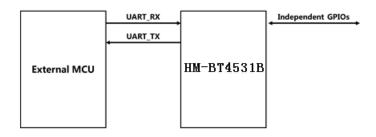


图 1 透传模块应用示意图

- 6 模块引脚
- 6.1 模块引脚分布

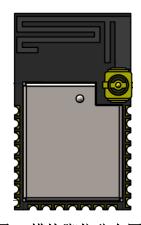


图 2 模块脚位分布图(正面视图)



图 3 模块脚位分布图(背面视图)



# 6.2 模块引脚定义

| Pin No | Pin Name | Туре | Description       |
|--------|----------|------|-------------------|
| 1      | PAO PAO  | I/0  | 通用 GPIO           |
| 2      | PA1      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 3      | PA2      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 4      | PA3      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 5      | PB0      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 6      | PA4      | I/0  | SWCLK; 串行调试编程接口时钟 |
| 7      | PA5      | I/0  | SWDIO; 串行调试编程接口数据 |
| 8      | PA6      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 9      | PB1      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 10     | PB2      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 11     | PB3      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 12     | 12 GND   |      | 电源地               |
| 13     | PB6      | I/0  | UART TXD          |
| 14     | PB7      | I/0  | UART RXD          |
| 15     | VCC      | DV   | 电源 3. 3V          |
| 16     | GND      | DG   | 电源地               |
| 17     | PB4      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 18     | PB5      | I/0  | 通用 GPIO           |
| 19     | PB10     | I/0  | 通用 GPIO           |
| 20     | PB12     | I/0  | 通用 GPIO           |
| 21     | PB11     | I/0  | 通用 GPIO           |
| 22     | PB13     | I/0  | 通用 GPIO           |
| 23     | 23 RES   |      | Reset 复位脚; 低电平有效  |

表1 模块引脚定义



# 7 模块尺寸

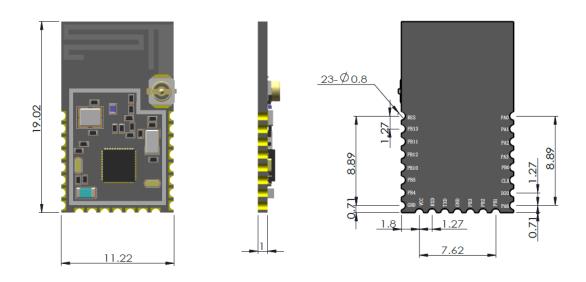


图 4 HM-BT4531B 模块尺寸图(不带屏蔽盖)

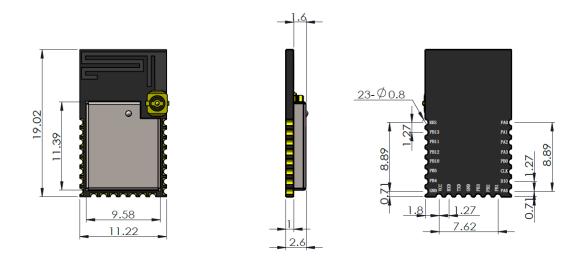
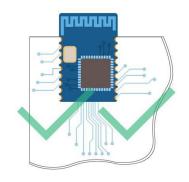


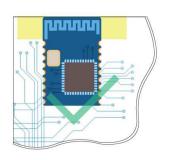
图 5 HM-BT4531B 模块尺寸图(带屏蔽盖)



#### 8 硬件设计注意事项

- 1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地:请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 2、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 3、在针对模块设计供电电路时,推荐保留 30%以上余量,有利于整机长期稳定 地工作,模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer,在模块接触部分的 Top Layer铺地(全部铺铜并良好接地),走线必须靠近模块数字部分,并走线在 Bottom Layer;
- 5、假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;
- 6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽:
- 7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线) 也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以 做适当的隔离与屏蔽;
- 8、通信线若使用 5V 电平, 必须使用电平转换电路;
- 9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的 TTL 协议,例如: USB3.0。
- 10、模块天线布局请参考下图:





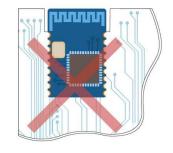


图 6 PCB 走线建议



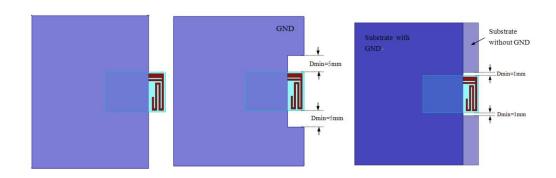


图 7 PCB 布局建议

#### 9 常见问题

#### 9.1 传输距离不理想

- 1、当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高:地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 2、海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差;
- 3、天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 5、室温下电源电压低于推荐值,电压越低发射功率越小:
- 6、使用天线与模块匹配程度较差,或天线本身品质有问题。

#### 9.2 易损坏——异常损坏

- 1、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久 性损坏;请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 2、请确保安装使用过程中的防静电操作,高频器件为静电敏感器件;
- 3、请确保安装使用过程中湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。



#### 9.3 误码率太高

- 1、附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- 2、电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性;
- 3、延长线、馈线品质太差或太长,也会造成误码率偏高。

#### 10 回流焊条件

- 1、加热方法: 常规对流或 IR 对流:
- 2、允许回流焊次数: 2次,基于以下回流焊(条件)(见下图):
- 3、温度曲线:回流焊应按照下列温度曲线(见下图);
- 4、最高温度: 245°C。

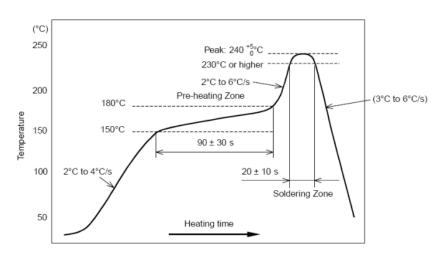


图 8 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

#### 11 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏,建议所有模块应在以下3个预防措施下处理:

- 1、必须遵循防静电措施,不可以裸手拿模块。
- 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变



化都可能导致设备不符合其认证要求的值限,从而模块会更容易受到损害

## 12. 文档变更记录

表 2. 文档变更记录

| 文档版本 | 变更描述 | 更新日期      |
|------|------|-----------|
| V1.0 | 首次发布 | 2023.4.03 |
|      |      |           |

## 13. 联系方式

深圳市华普微电子股份有限公司

地址:深圳市南山区西丽街道万科云城三期 8 栋 A 座 30 层

电话: +86-0755-82973805

邮箱: sales@hoperf.com

网址: http://www.hoperf.cn